

杭州晶华微电子股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）于 2025 年 4 月 19 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 23 日发布了《2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，现对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行总结，并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质效

（一）2025 年公司经营情况

2025 年，公司在持续深耕并拓展医疗健康及工业仪表芯片领域的基础上，通过整合与研发，业务延伸至智能家电及电池管理（BMS）芯片领域，产品矩阵进一步丰富。报告期内，公司实现营业收入 17,358.47 万元，同比增长 28.73%；实现归属于母公司所有者的净利润-4,213.89 万元，同比增亏 310.31%。公司净利润亏损增加，主要系：1）公司围绕长期竞争能力提升，持续强化研发、丰富产品矩阵、市场拓展及人才引进等方面的资源保障，公司经营费用同比增加；2）并购整合产生的非经常性损益以及计提商誉减值等事项，对当期利润造成影响。报告期内，公司主营业务毛利率为 51.29%，同比减少 7.85 个百分点，主要系新增晶华智芯并表影响。其中，晶华微主营业务毛利率 57.15%，同比减少 1.99 个百分点，晶华智芯主营业务毛利率 31.90%。

1、主营业务稳步推进

（1）医疗健康领域

2025 年度，公司医疗健康 SoC 芯片产品销量同比增长 5.25%，收入同比增长 4.13%，占公司主营业务收入比例 35.86%。其中，红外测温芯片产品销量同比增长 22.84%，收入同比增长 6.98%，主要系公司加大推广及调整营销策略，以价

换量抢占市场；智能健康衡器芯片产品销量同比增长 0.72%，收入同比下降 14.95%，主要系市场竞争加剧及为优化库存结构，公司对部分积压库存清理变现；人体健康参数测量（血糖血压血氧等）芯片产品销量同比增长 42.99%，收入同比增长 164.67%，主要系公司带 HCT 功能的血糖仪专用芯片已向国内头部品牌客户完成批量交付并持续放量。

（2）工控仪表领域

2025 年度，公司工业控制及仪表芯片产品销量同比增长 3.48%，收入同比下降 3.17%，占公司主营业务收入比例 40.94%。其中，工业控制芯片产品销量同比增长 44.40%，收入同比增长 18.08%，主要系公司大力推广新一代变送器单芯片解决方案和 4-20mA 电流环 DAC 芯片解决方案，实现大客户突破并已规模出货；仪器仪表芯片产品销量同比增长 0.87%，收入同比下降 8.45%，主要系受终端市场变化、竞争加剧及销售价格调整所致。

（3）智能感知领域

2025 年度下半年，公司推出新一代的数字 PIR 传感器专用芯片项目，更匹配客户使用需求，更具高性价比，可应用于照明控制、马达和电磁控制、防盗报警等领域。此外，晶华智芯主要产品系智能家电控制芯片，属于智能感知芯片业务。2025 年度，晶华智芯 78 系列高性能触控显示智能控制芯片及 72JE 系列高性价比小家电触控芯片均已完成流片并已推出量产样品，至本报告披露日，78 系列芯片已在重点客户陆续验证导入，72JE 芯片已开始陆续批量出货，系列产品在苏泊尔、美菱等品牌终端客户推进导入中。报告期内，智能感知领域占公司主营业务收入比例 22.47%。

（4）电池管理领域

2025 年度，依托前期持续研发投入及成都分公司高端人才引入，公司已构建覆盖单节高精度锂电保护芯片、3-17 串 BMS 模拟前端芯片和电量计芯片的完整解决方案，满足消费电子、电动工具，智能清洁家居到轻型电动车、无人机和储能系统等多元化应用场景的需求。报告期内，公司 BMS 芯片已成功导入多家客户实现批量出货，并逐步导入行业头部客户和知名终端品牌，产品性能与可靠性得到市场验证和认可，产品规模放量销售尚需时间，报告期内收入占比较小。

此外，报告期内，为更好满足现有客户需求并与现有产品线形成配套（如医

疗健康领域的动态血糖监测 CGM、电池管理领域的两轮车应用等), 实现“AFE + MCU + 无线传输 + 数据分析 + 应用方案”的全链条服务能力, 公司新设物联网无线传输产品线。物联网无线传输市场空间广阔, 该布局也将助力公司拓展增量市场。

2、研发投入持续加码

报告期内, 公司保持高强度的研发投入, 研发费用 9,705.66 万元, 同比增长 33.00%, 占营业收入比重为 55.91%。截至报告期末, 公司研发人员 138 名, 占员工总数 61.06%。

2025 年度, 公司新立项芯片研发项目 18 个, 同比增长 125.00%, 公司在研芯片项目数量同比增长 36.96%, 流片次数同比提升 112.50%, 研发活动保持高活跃度。报告期内, 公司在各产品领域研发取得积极进展:

医疗健康领域, 重点推进 3V 双通路动态血糖仪模拟前端芯片项目, 目前样片测试良好, 正在进行样机开发与应用验证; 此外, 带 20bit ADC 和 LCD 驱动的高性价比新工艺 SoC 芯片项目、4/8 电极 BIA AFE 芯片项目已完成流片, 进入测试验证阶段。

工控仪表领域, 中高端万用表 SoC 芯片已完成初步样片测试, 正在制作 demo 样机进行整机验证。

智能感知领域, 全功能 32 位智能家电 MCU 控制器芯片、72XX 系列高性价比增强型 8 位 MCU 控制器芯片已完成研发设计, 进入推广销售阶段; 带有 I/O 全映射和 8051 核的高性价比 MCU 芯片已完成研发设计及方案开发, 获得客户认可, 该芯片可与公司 BMS AFE 芯片配套, 为客户提供一站式解决方案。

电池管理领域, 18-26 串锂/钠电池监控和保护芯片正在进行优化迭代; 集成二级电压保护的 3-7 串锂电池 AFE 芯片项目已完成样片测试, 正在推广试用中。

3、保供稳链, 协同增效

报告期内, 公司持续强化供应链管理, 积极开展与晶圆代工厂、封装测试厂的深度合作, 且与晶华智芯共享供应商资源, 丰富核心环节供应商储备, 为保障产能供应稳定提前布局。同时, 公司新设质量与可靠性中心, 全面升级生产运营与质量管理体系, 强化产品全流程管控, 提升交付可靠性与客户响应效率。在库存管理方面, 公司持续优化库存结构, 积极消化前期积压存货, 库存周转率同比

提升 12.40%，期末存货余额同比下降 4.45%，存货结构得到有效改善。

4、整合融合，夯实基础

公司围绕“精管协同”原则，系统推进与晶华智芯、成都分公司等新团队整合管理：一是平衡管控与创新，在财务风控等核心制度上快速对齐，同时尊重及保留新团队灵活机制；二是推动资源共享，整合研发资源与客户渠道，建立统一技术平台和共享供应链体系；三是强化团队融合，通过项目交流、团建活动等方式增进沟通，凝聚共同目标。后续，公司将通过加速资源整合、推进新品推广、强化精细化成本管控，着力提升整体运营效率与盈利能力。

5、规范管理，提升效能

报告期内，公司持续深化内控合规建设，稳步推进内控体系迭代。一是完成子公司晶华智芯全流程内控制度编制，覆盖研发、销售、供应链及日常运营各环节。二是聚焦募集资金使用、人力资源管理、销售业务、研发管理、供应链采购等关键领域，持续优化核心内控制度与流程。三是同步开展知识产权及法律法规专项培训，修订完善知识产权管理、商业秘密保护等制度，废止失效制度，提升员工合规意识。通过强化全流程合规管控，有效提升运营效率，为公司稳健发展提供保障。

(二) 2026 经营质效提升行动方案

2026 年，公司立足发展战略与业务实际，结合宏观形势与行业趋势，重点围绕以下三个方面推进研发与销售，驱动业务成长：

1、研发创新：整合资源，构建多元产品矩阵

公司专注医疗健康、工控仪表、智能家电、电池管理及物联网无线通讯五大核心领域，围绕客户需求拓展新产品，进一步完善产品矩阵，为客户提供更丰富的芯片产品组合及一站式解决方案。公司将推进各产品线研发资源的深度整合，通过技术平台共享与团队协同攻关，提升研发效率与成果转化水平。

2、业务拓展：整合渠道，加快新品导入抢占市场

整合公司内外部市场资源，强化销售渠道协同与客户资源共享，形成覆盖更广、触达更深的营销网络。加快各产品线新产品的市场导入节奏，以差异化产品策略和精准营销，抢占市场份额，实现新老产品的协同放量。

3、保供稳产：强化供应保障，优化库存管理

面对产能紧张与上游涨价的外部环境，公司将进一步加强与核心供应商的深入合作，丰富关键环节供应商储备，保障产能安全与供应韧性，确保交付及时性与稳定性。同时，动态优化库存管理，合理控制备货水平，避免库存积压风险。

二、加强募投项目管理，提升科技创新能力

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 56,582.51 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 7 月 26 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
一、募集资金总额	104,798.72
其中：超募资金金额	17,053.70
减：直接支付发行费用	12,745.02
二、募集资金净额	92,053.70
减：	
以前年度已使用金额	26,995.53
本年度使用金额	13,132.76
现金管理金额	30,000.00[注 1]
加：	
募集资金利息收入	4,657.10[注 2]
三、报告期期末募集资金余额	26,582.51[注 3]

[注 1]截至 2025 年 12 月 31 日，理财产品余额 30,000.00 万元尚未到期

[注 2]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额

[注 3]包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额

自首发募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施工作，审慎规划募集资金的使用。但由于经历了半导体市场周期性调整及需求结构性下滑，全球消费电子市场需求疲软，半导体行业持续了较长的去库存阶段，且因行业技术快速

迭代，客户需求与市场竞争状况也不断演变，为应对市场环境的变化，提高募投项目的整体质量和募集资金的使用效果，公司紧密结合市场的最新动态以及客户的切实需求，基于合理有效使用募集资金的原则，在募投项目的推进上更加谨慎、严谨、科学，整体进度较原计划适当放缓，以有效控制成本、降低风险、提高资产流动性。公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2025 年 7 月 29 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，“智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目”“工控仪表芯片升级及产业化项目”“研发中心建设项目”实施期限延长至 2027 年 7 月，“高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目”终止实施，“研发中心建设项目”增加实施主体全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司，增加实施内容智能家电控制芯片的开发设计研究。

2026 年，公司将积极推进上述终止募投项目所涉剩余募集资金投入新项目，确保资金合理配置、高效利用；同时加快推动延期募投项目的建设进度，科学安排实施节奏。公司将持续加强募投项目管理，审慎使用募集资金，进一步提高募集资金使用效率，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，增强公司整体盈利能力。

三、优化财务管理，增强组织效能

公司高度重视财务管理，报告期内，持续加强与各业务部门的紧密联系，增强业务管控与监督力度，切实提高会计核算的及时性和准确性，确保财务报告信息质量；同时，公司始终与会计师事务所保持紧密沟通，提高财务核算准确度；公司持续优化库存结构，积极消化前期积压存货，库存周转率同比提升 12.40%，期末存货余额同比下降 4.45%，存货结构得到有效改善；为全面反映企业经营成果与财务状况，通过对收入、成本、毛利等数据的梳理，公司定期编制财务分析报告，以便及时发现经营管理中的问题与潜在风险，为成本管控、资金调度、盈利提升提供数据支撑并助力公司实现精细化管理；在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，公司充分利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，确保持续收益的稳定性和可持续性，实现资金效益最大化。

2026 年，公司将深化预算管理，强化资金全过程管控，进一步完善科学规范

的财务运行机制，持续通过供应链管理、库存管理、应收账款管理与现金流管理等方面，提高经营效率，加强资金使用监管，进一步夯实风险管理能力，以应对市场变化和挑战，促进公司可持续发展。

四、规范内控管理，提升运营效率

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求建立由股东会、董事会和经营管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制。

报告期内，公司高度重视企业规范治理及合规运营效率，持续梳理公司内部控制及执行情况，不断优化和健全内控体系与制度流程。根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，公司于2025年7月10日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年7月29日召开了公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时完成了对《公司章程》及内部治理制度的修订和完善，确保公司内部控制的合规有效，进一步从制度建设层面夯实业务风险管控基础。

此外，报告期内公司组织独立董事参加两年一次的后续培训，同时积极深化独立董事履职机制，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，听取独立董事对于公司加强内部控制风险防范机制的重要性的建议，及时向独立董事报告公司的相关重大事项，保障独立董事的知情权、监督权，努力提升公司治理的合规性、有效性和开放性。公司亦积极组织董事、高级管理人员及相关人员参与证监会、交易所和各级上市公司协会等举办的培训，不断提升其专业素养和合规意识，以推动公司董事和高级管理人员尽职履责。报告期内，公司已组织董事和高级管理人员参加了上市公司董事、高管初任培训、关键少数信息披露规范运作专题培训、提质增效专题培训、并购重组专题培训和市值管理专题培训等，深入学习证券市场相关法律法规，确保公司运作的规范性和合规性；公司已邀请律师事务所对董事、高级管理人员及相关人员进行合规履职及股份交易行为规范培训，不断强化其合规意识，防范违规风险。

2026年，公司将紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司治理

制度，提升规范运作水平和风险防范能力。同时，公司将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法权益。公司也将继续提升董事、高级管理人员的专业素养，通过常态化参与监管培训，精准把握政策动态，确保董事及高级管理人员勤勉履职，推动公司持续规范运作。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司始终坚持投资者利益至上原则，并已建立了长期、稳定、持续的股东分红回报机制，充分保障全体股东的合法权益。

报告期内，公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现金红利，不送红股。2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 93,126,248 股变更为 120,891,094 股。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2026 年，公司将在保证正常经营的前提下，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，从有利于公司可持续发展和投资者长期回报的角度出发，与广大投资者共享公司发展成果。

六、提高信披质量，加强投关交流

报告期内，公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。同时，公司以投资者需求为导向，持续提升信息披露内容的可读性和有效性，切实维护投资者权益。

公司亦注重投资者关系管理工作，为加强与投资者的沟通交流，公司也借助新媒体平台工具，在合规范围内传递公司经营情况和技术创新等信息，扩大了信息传播的覆盖面，确保了信息披露的广泛性和平等性。报告期内，公司通过“上证路演中心”等平台举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，参与了2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会，并召开了2025年第三季度业绩说明会，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。除此之外，公司组织、参加了十多场次的投资者沟通交流活动，并通过投资者热线、投资者调研、上证e互动、电子邮箱等多种形式，加强与投资者交流的力度与频次。

2026年，公司继续严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，积极履行各项信息披露义务，提升公司信息披露的质量和透明度。公司将进一步深化与资本市场的双向互动，拓展交流形式的广度与深度，通过业绩说明会、投资者热线、投资者调研、上证e互动、电子邮箱等多种形式，将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，增进交流互信，维护投资者权益。

七、强化利益共担共享，压实“关键少数”责任

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事长吕汉泉先生根据已披露的增持计划增持公司股份。截至2025年3月28日，增持主体累计增持公司股份571,200股，增持金额合计人民币15,318,585.08元（不含交易费用），增持计划已实施完毕。

公司持续完善长效激励体系，通过股权激励等多元化方式有效激发管理团队与核心人才的积极性，公司自上市以来推出了2023年限制性股票激励计划和2024年限制性股票激励计划。报告期内，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司为满足归属条件的激励对象办理了股票归属登记事宜；2024年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，公司已向相应激励对象完成预留部分限制性股票授予。

增持计划、股票激励计划能进一步激发公司股东、管理层及员工等的责任感、使命感，强化目标责任意识，使其利益与公司长远发展有机结合，提升公司发展

质量，增强投资者回报，切实强化管理层及核心骨干与股东利益的共担共享。

此外，公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。公司通过培训、合规提醒等方式持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。同时，公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，与独立董事建立了常态化沟通机制，充分发挥其在公司治理中的监督作用。

2026年，公司将根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立董事和高级管理人员薪酬管理制度，完善激励约束机制，提升公司薪酬管理规范性水平，保护公司股东的利益。同时，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，积极组织相关方参加监管机构举办的各种培训，不断强化合规意识，赋能“关键少数”引领企业持续稳定发展。

八、持续评估完善行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2026年4月29日